

SAC305リフロープロファイル対応 低Ag合金ハロゲンフリーソルダペースト

S1XBIG58-M650-7 Sn 1.1Ag 0.7Cu 1.8Bi + Ni

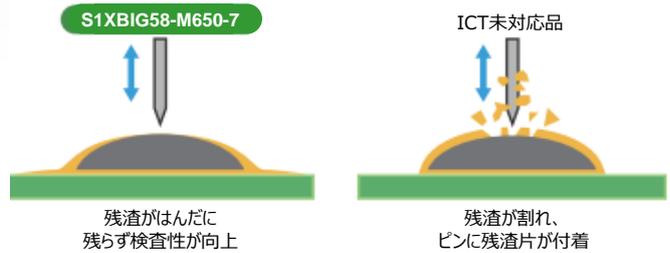


ICT性要求に対応した、これからの低Ag合金

ピンへのフラックス残渣付着を防止

はんだ上にフラックス残渣が厚く残っていると導通を妨げることがあり、基板に全く不良がなくても不良の判定が出ることがあります。
S1XBIG58-M650-7でははんだ溶融時のフラックスの流れを良好に保ち、はんだ上にフラックス残渣を残しません。また、フラックス残渣の粘着性を抑えて、ピンへの付着を防ぎます。

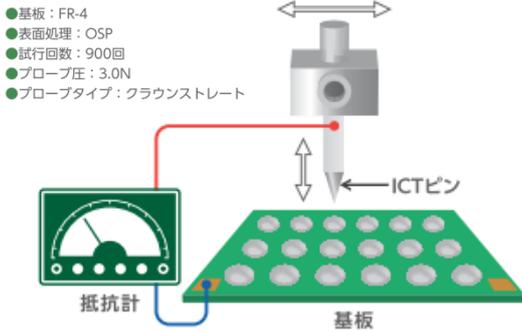
■ ICT検査結果例



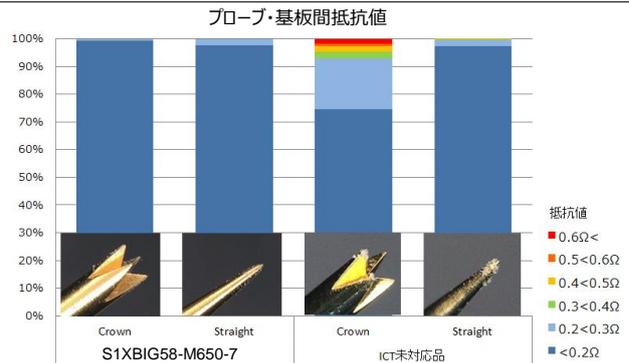
チェッカーピンコンタクト性を大幅改善

ピンが確実にはんだに接触するほか、残渣片の付着が少なく、高い測定精度が得られます。

■ チェッカーピンコンタクト性試験



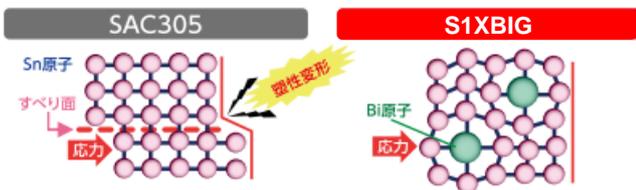
- 基板：FR-4
- 表面処理：OSP
- 試行回数：900回
- プローブ圧：3.0N
- プローブタイプ：クラウンストレート



BiとNiによる「ハイブリッド」強化で経時的な組織変化を抑制

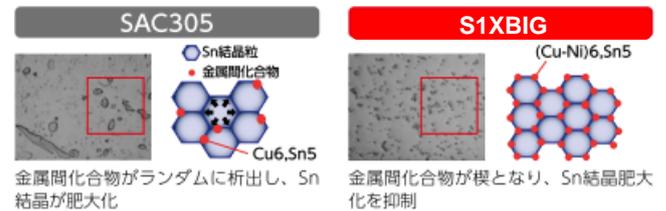
原子サイズの異なるBiがSnの原子配列に歪みを生じさせ、応力による塑性変形を抑制します。

■ Biがもたらす原子レベルの固溶強化



NiがSn結晶界面に細かく一様に分散することで、冷熱サイクルによる組織変化と、高温時のSn結晶肥大化を抑制します。

■ Niがもたらす析出強化 (-40 ⇔ 125°C x 2000サイクル後)



製品物性表

製品名	S1XBIG58-M650-7
合金	Sn 1.1Ag 0.7Cu 1.8Bi + Ni
融点 (°C)	211-223
粉末粒度 (μm)	20-38
粘度 (Pa·s)	200
フラックス含有量 (%)	11.2
ハライド含有量 (%)	0
フラックスタイプ	ROLO

ICTテスト対応	ハロゲンフリー
枕不良防止	低ボイド
フィンバターン 0.4mmピッチ CSP>0.3mmφ	タック時間 >48時間
無洗浄タイプ	No-clean